



特性

- 》良好的热传导率: **6.5 W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

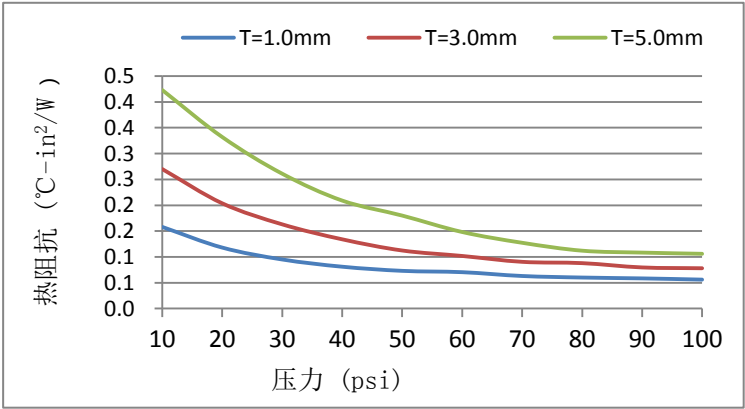
应用

- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

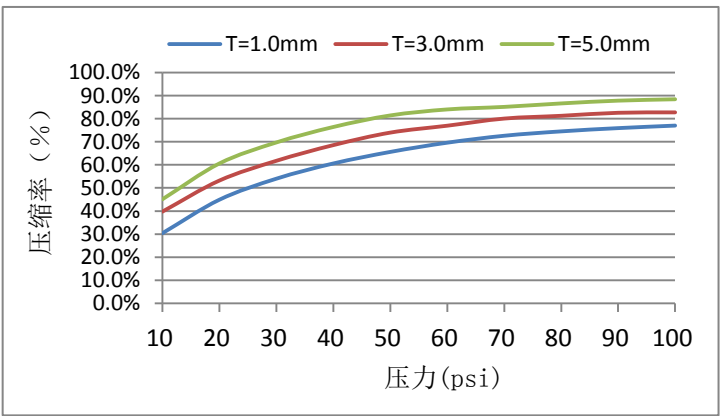
TIF™500-65-11US是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上, 从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

TIF™500-65-11US 系列特性表		
产品特性	典型值	测试方法
颜色	灰色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)	ASTM D374
硬度 (Shore 00)	20	ASTM 2240
密度 (g/cm³)	3.45	ASTM D792
使用温度范围	-40~160℃	*****
击穿电压 (T=1.0mm, Vac)	≥6000	ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.5	ASTM D150
体积电阻率	≥1.0X10 ¹² Ohm-cm	ASTM D257
导热系数 (W/mK)	6.5	ASTM D5470
	6.5	ISO22007-2.2
防火等级	94 -V0	UL E331100

热阻抗



压缩率



标准厚度:0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)

标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

安全处置方法无需特别防护, 存储方法低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射即可, 详细方法可参考产品物质安全资料表。

导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大:
Tel:+001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

中国:
Tel: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw

台湾:
Tel:+886-2-22771007
E-mail:frances@ziitek.com.tw

以上资料与说明是兆科实验室测试所得,结果准确有效, 但不作为法律的解释或保证,用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。



2020/12/10